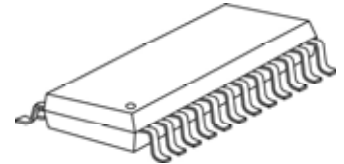




特色

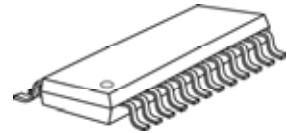
- 16 个恒流输出通道
- 恒流输出值不受输出端负载电压影响
恒流范围值:
3-45mA@V_{DD}=5V;
3-30mA@V_{DD}=3.3V
- 极为精确的电流输出值,
通道间最大差异值: ±1.5% (一般值) 与 ±3% (最大值);
芯片间最大差异值: ±3% (一般值) 与 ±6% (最大值)。
- 低转折电压:
I_{OUT}=20mA@V_{DS}=0.2V; V_{DD}=3.3V
I_{OUT}=20mA@V_{DS}=0.2V; V_{DD}=5.0V
- 利用一个外接电阻, 可调整电流输出值
- 快速的输出电流响应, \overline{OE} : 70ns (保持输出一致性的条件下)
- 输出端的交错延迟时间
- 高达 25MHz 时钟频率
- 具 Schmitt trigger 输入装置
- 操作电压: 3.3 与 5 伏特
- “Pb-Free & Green”封装

Small Outline Package



GF: SOP24L-300-1.00

Shrink SOP



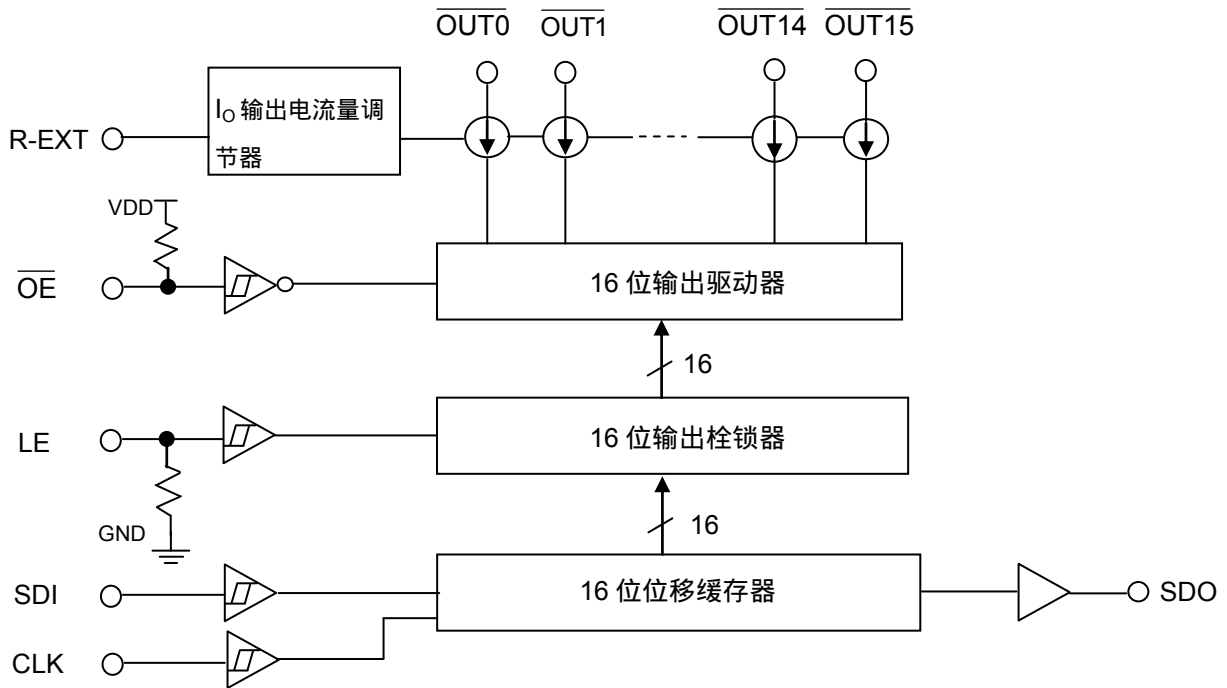
GP: SSOP24L-150-0.64

产品说明

MBI5035 是款低功耗 LED 驱动器, 以 I_{OUT}=20mA 时仅 V_{DS}=0.2V 的低转折电压(LKV)超越传统的驱动器设计。此低转折电压设计能确保 MBI5035 保持恒流与 PrecisionDrive™ 的优异特性。MBI5035 内建 16 位位移寄存器可以将串行的输入资料转换成每个输出信道的灰阶像数。而且, MBI5035 的 16 个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响并提供一致并且恒定的输出电流。

MBI5035 的输入电压范围值为 3.3 伏特至 5 伏特, 提供 16 个电流源, 可以在每个输出级提供 3~45mA 定电流量以驱动 LED。使用者可以经由选用不同阻值的外接电阻器来调整 MBI5035 各输出级的电流大小, 藉此机制, 使用者可精确地控制 LED 的发光亮度。MBI5035 的设计保证其输出级可耐压 17 伏特, 因此可以在每个输出端串接多个 LED。此外, MBI5035 亦提供 25MHz 的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。

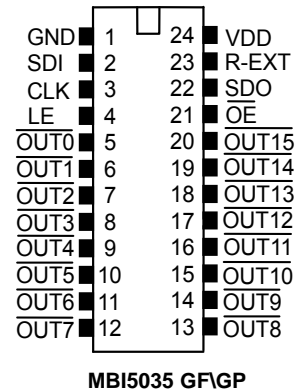
功能方块图



脚位说明

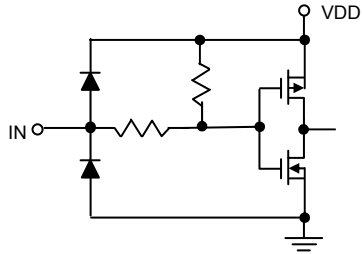
Pin 脚名称	功能	Pin 脚名称
1	GND	控制逻辑及驱动电流之接地端。
2	SDI	输入至位移寄存器之串行数据输入端。
3	CLK	时钟讯号之输入端 ;资料位移会发生在时钟上升缘。
4	LE	数据闪控(data strobe)输入端。 当 LE 是高电位时, 串行数据会被传入至输出栓锁器; 当 LE 是低电位时, 资料会被栓锁住。
5~20	$\overline{\text{OUT0}} \sim \overline{\text{OUT15}}$	恆流输出端。
21	$\overline{\text{OE}}$	输出致能讯号端。 当 $\overline{\text{OE}}$ 是低电位时, 即会启动 $\overline{\text{OUT0}} \sim \overline{\text{OUT15}}$ 输出; 当 $\overline{\text{OE}}$ 是高电位时, $\overline{\text{OUT0}} \sim \overline{\text{OUT15}}$ 输出会被关闭(不驱动电流)。
22	SDO	串行数据输出端; 可接至下一个驱动器之 SDI 端。
23	R-EXT	连接外接电阻之输入端; 此外接电阻可设定所有输出通道之输出电流。
24	VDD	3.3V/5V 电源供应端。

脚位图

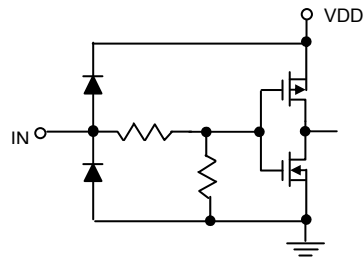


输入及输出等效电路

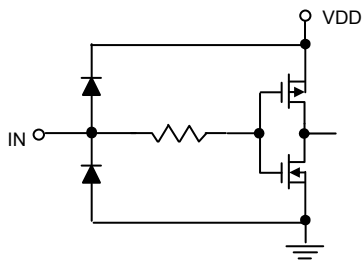
\overline{OE} 输入端



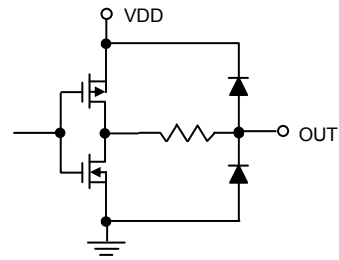
LE 输入端



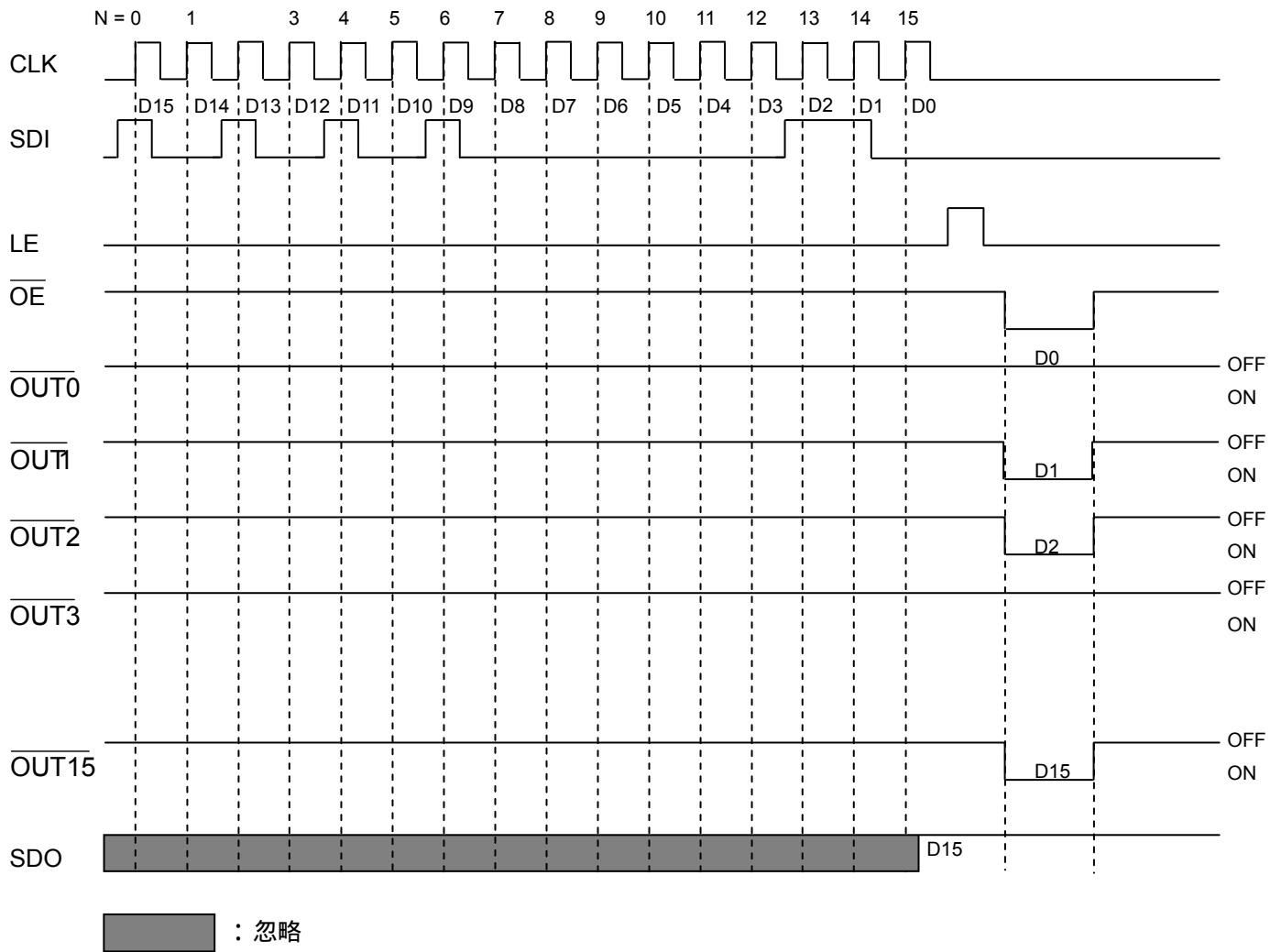
CLK, SDI 输入端



SDO 输出端



时序图



真值表

CLK	LE	\overline{OE}	SDI	$\overline{OUT0} \dots \overline{OUT7} \dots \overline{OUT15}$	SDO
	H	L	D_n	$\overline{D_n} \dots \overline{D_{n-7}} \dots \overline{D_{n-15}}$	D_{n-15}
	L	L	D_{n+1}	不变	D_{n-14}
	H	L	D_{n+2}	$\overline{D_{n+2}} \dots \overline{D_{n-5}} \dots \overline{D_{n-13}}$	D_{n-13}
	X	L	D_{n+3}	$\overline{D_{n+2}} \dots \overline{D_{n-5}} \dots \overline{D_{n-13}}$	D_{n-13}
	X	H	D_{n+4}	使LED不亮	D_{n-13}

最大工作范围

特性		代表符号	最大工作范围	单位
电源电压		V_{DD}	0~7.0	V
输入端电压		V_{IN}	-0.4~ $V_{DD}+0.4$	V
输出端电流		I_{OUT}	+50	mA
输出端电压		V_{DS}	-0.5~+17.0	V
接地端电流		I_{GND}	+800	mA
消耗功率 (在印刷电路板上, 25°C时)*	GF-type	P_D	2.35	W
	GP-type		1.76	
热阻值 (在印刷电路板上, 25°C时)*	GF-type	$R_{th(j-a)}$	53.28	°C/W
	GP-type		70.90	
接合点温度		$T_{j,max}$	150**	°C
IC工作时的环境温度		T_{opr}	-40~+85	°C
IC储存时的环境温度		T_{stg}	-55~+150	°C

*模拟时, PCB尺寸为76.2mm*114.3mm。参考JEDEC JESD51标准。

注: 散热表现是与散热片面积、PCB层数与厚度相关。实测热阻值会与模拟值有所不同。使用者应根据所欲达到的散热表现, 选择合适的封装与PCB布局, 以增加散热能力。

**越接近此最大范围值操作, IC的寿命越短、可靠度越低; 超过此最大限定范围工作时, 将会影响IC运作并造成毁损, 因此建议IC工作时的接合点温度在125°C以内。

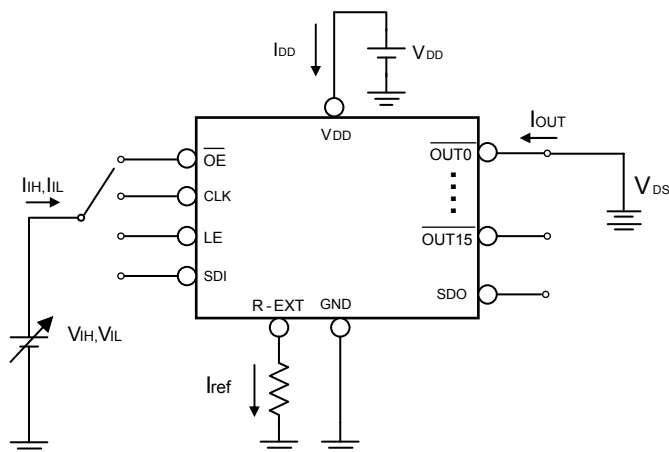
直流特性 ($V_{DD} = 5.0V$)

特性		代表符号	量测条件	最小值	一般值	最大值	单位
电源电压		V_{DD}	-	4.5	5.0	5.5	V
输出端电压		V_{DS}	$\overline{OUT0} \sim \overline{OUT15}$	-	-	17.0	V
输出端电流		I_{OUT}	参考直流特性量测电路	3	-	45	mA
		I_{OH}	SDO	-	-	-1.0	mA
		I_{OL}	SDO	-	-	1.0	mA
输入端电压	高电位位准	V_{IH}	$T_a = -40 \sim 85^\circ C$	$0.7 \times V_{DD}$	-	V_{DD}	V
	低电位位准	V_{IL}	$T_a = -40 \sim 85^\circ C$	GND	-	$0.3 \times V_{DD}$	V
输出端漏电流		I_{OH}	$V_{DS} = 17.0V$	-	-	0.5	μA
输出端电压	SDO	V_{OL}	$I_{OL} = +1.0mA$	-	-	0.4	V
		V_{OH}	$I_{OH} = -1.0mA$	$V_{DD} - 0.4$	-	-	V
输出电流1		I_{OUT1}	$V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930 \Omega$	-	20	-	mA
电流偏移量(通道间)		dI_{OUT1}	$I_{OUT} = 20mA$ $V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930 \Omega$	-	± 1.5	± 3.0	%
电流偏移量(芯片间)		dI_{OUT2}	$I_{OUT} = 20mA$ $V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930 \Omega$	-	± 3.0	± 6.0	%
电流偏移量 vs. 输出电压		$\%/dV_{DS}$	V_{DS} within 0.5V and 1.5V	-	± 0.2	± 0.5	$\%/V$
电流偏移量 vs. 电源电压		$\%/dV_{DD}$	V_{DD} within 4.5V and 5.5V	-	± 1.0	± 2.0	$\%/V$
低转折电压		V_{DS}	$I_{OUT} = 20mA$	-	0.2	0.25	V
Pull-up电阻		$R_{IN(up)}$	\overline{OE}	250	500	800	K Ω
Pull-down电阻		$R_{IN(down)}$	LE	250	500	800	K Ω
电压源 输出电流	"OFF"	$I_{DD(off) 1}$	$R_{ext} = \text{Open}, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = \text{Off}$	-	4.0	6.0	mA
		$I_{DD(off) 2}$	$R_{ext} = 6000\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = \text{Off}$	-	5.5	7.5	
		$I_{DD(off) 3}$	$R_{ext} = 930\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = \text{Off}$	-	8.0	10	
	"ON"	$I_{DD(on) 1}$	$R_{ext} = 6000\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = \text{On}$	-	5.5	7.5	
		$I_{DD(on) 2}$	$R_{ext} = 930\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = \text{On}$	-	8.0	10	

直流特性 ($V_{DD} = 3.3V$)

特性		代表符号	量测条件	最小值	一般值	最大值	单位
电源电压		V_{DD}	-	3.0	3.3	3.6	V
输出端电压		V_{DS}	$\overline{OUT0} \sim \overline{OUT15}$	-	-	17.0	V
输出端电流		I_{OUT}	Refer to "Test Circuit for Electrical Characteristics"	3	-	30	mA
		I_{OH}	SDO	-	-	-1.0	mA
		I_{OL}	SDO	-	-	1.0	mA
I 输入端电压	高电位位准	V_{IH}	$T_a = -40 \sim 85^\circ C$	$0.7 \cdot V_{DD}$	-	V_{DD}	V
	低电位位准	V_{IL}	$T_a = -40 \sim 85^\circ C$	GND	-	$0.3 \cdot V_{DD}$	V
输出端漏电流		I_{OH}	$V_{DS} = 17.0V$	-	-	0.5	μA
输出端电压	SDO	V_{OL}	$I_{OL} = +1.0mA$	-	-	0.4	V
		V_{OH}	$I_{OH} = -1.0mA$	$V_{DD} - 0.4$	-	-	V
输出电流1		I_{OUT1}	$V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930 \Omega$	-	20	-	mA
电流偏移量(通道间)		dI_{OUT1}	$I_{OUT} = 20mA$ $V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930\Omega$	-	± 1.5	± 3.0	%
电流偏移量(芯片间)		dI_{OUT2}	$I_{OUT} = 20mA$ $V_{DS} = 0.25V$ $R_{ext} = 930\Omega$	-	± 3.0	± 6.0	%
电流偏移量 vs. 输出电压		$\%/dV_{DS}$	V_{DS} within 0.5V and 1.5V	-	± 0.2	± 0.5	%/V
电流偏移量 vs. 电源电压		$\%/dV_{DD}$	V_{DD} within 3.0V and 3.6V	-	± 1.0	± 2.0	%/V
低转折电压		V_{DS}	$I_{OUT} = 20mA$	-	0.2	0.25	V
Pull-up电阻		$R_{IN(up)}$	\overline{OE}	250	500	800	K Ω
Pull-down电阻		$R_{IN(down)}$	LE	250	500	800	K Ω
电压源 输出电流	"OFF"	$I_{DD(off) 1}$	$R_{ext} = Open, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = Off$	-	3.5	5.5	mA
		$I_{DD(off) 2}$	$R_{ext} = 6000\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = Off$	-	5.0	7.0	
		$I_{DD(off) 3}$	$R_{ext} = 930\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = Off$	-	7.5	9.5	
	"ON"	$I_{DD(on) 1}$	$R_{ext} = 6000\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = On$	-	5.0	7.0	
		$I_{DD(on) 2}$	$R_{ext} = 930\Omega, \overline{OUT0} \sim \overline{OUT15} = On$	-	7.5	9.5	

直流特性的测试电路



动态特性 ($V_{DD} = 5.0V$)

特性		代表符号	量测条件	最小值	一般值	最大值	单位
延迟时间 (低电位到高电位)	LE- $\overline{OUT0}$	t_{pLH1}	$V_{IH}=V_{DD}$ $V_{IL}=GND$ $R_{ext}=930\Omega$ $R_L=150\Omega$ $C_L=10PF$ $I_{OUT}=20mA$ $C1=100nF$ $C2=22\mu F$ $C_{SDO}=10PF$ $V_L=3.3V$	-	55	65	ns
	\overline{OE} - $\overline{OUT0}$	t_{pLH2}		-	55	65	ns
	CLK-SDO	t_{pLH}		-	-	40	ns
延迟时间 (高电位到低电位)	LE- $\overline{OUT0}$	t_{pHL1}		-	35	45	ns
	\overline{OE} - $\overline{OUT0}$	t_{pHL2}		-	35	45	ns
	CLK-SDO	t_{pHL}		-	-	40	ns
输出交错延迟时间*	Output Group 1~ Output Group 2	t_{stag1}		-	5	10	ns
脉波宽度	CLK	$t_{w(CLK)}$		20	-	-	ns
	LE	$t_{w(L)}$		20	-	-	ns
数据时钟频率		F_{CLK}		-	-	25	MHz
LE的停留时间		$t_{h(L)}$		10	-	-	ns
LE的设定时间		$t_{su(L)}$		10	-	-	ns
SDI的停留时间		$t_{h(D)}$		5	-	-	ns
SDI的设定时间		$t_{su(D)}$		3	-	-	ns
CLK讯号的最大爬升时间		t_r		-	-	500	ns
CLK讯号的最大下降时间		t_f		-	-	500	ns
SDO 的爬升时间		$t_{r,SDO}$		-	10	-	ns
SDI 的下降时间		$t_{f,SDI}$		-	10	-	ns
电流输出埠的电位爬升时间		t_{or}		-	30	40	ns
电流输出埠的电位下降时间		t_{of}		-	30	40	ns
\overline{OE} 脉波宽度		$t_{w(OE)}$	70	100	-	ns	

*MBI5035 内建延迟电路功能,奇数信道 $\overline{OUT2n+1}$ 与偶数信道 $\overline{OUT2n}$ 间的延迟时间为 5ns,可将奇数与偶数的输出通道在不同的时间导通来降低电源线的电流量

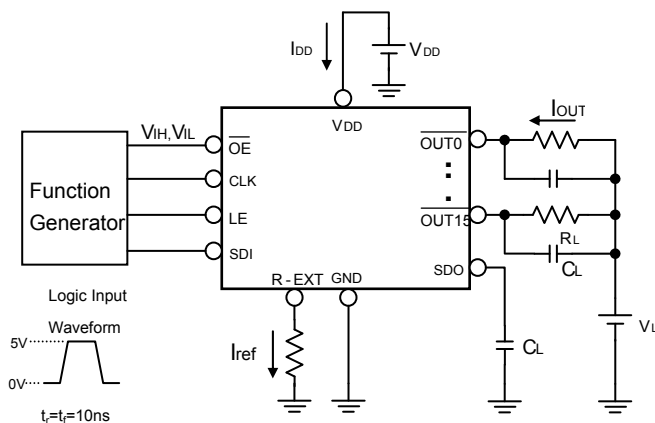
动态特性 ($V_{DD} = 3.3V$)

特性	代表符号	量测条件	最小值	一般值	最大值	单位
延迟时间 (低电位到高电位)	LE- $\overline{OUT0}$	t_{pLH1}	-	65	75	ns
	$\overline{OE} - \overline{OUT0}$	t_{pLH2}	-	65	75	ns
	CLK-SDO	t_{pLH}	-	-	50	ns
延迟时间 (高电位到低电位)	LE- $\overline{OUT0}$	t_{pHL1}	-	40	50	ns
	$\overline{OE} - \overline{OUT0}$	t_{pHL2}	-	40	50	ns
	CLK-SDO	t_{pHL}	-	-	50	ns
输出交错延迟时间*	Output Group 1~ Output Group 2	t_{stag1}	-	10	15	ns
脉波宽度	CLK	$t_w(CLK)$	20	-	-	ns
	LE	$t_w(L)$	20	-	-	ns
数据时钟频率		F_{CLK}	-	-	20	MHz
LE的停留时间		$t_h(L)$	10	-	-	ns
LE的设定时间		$t_{su}(L)$	10	-	-	ns
SDI的停留时间		$t_h(D)$	5	-	-	ns
SDI的设定时间		$t_{su}(D)$	3	-	-	ns
CLK讯号的最大爬升时间		t_r	-	-	500	ns
CLK讯号的最大下降时间		t_f	-	-	500	ns
SDO 的爬升时间		$t_{r,SDO}$	-	10	-	ns
SDI 的下降时间		$t_{f,SDI}$	-	10	-	ns
电流输出埠的电位爬升时间		t_{or}	-	35	45	ns
电流输出埠的电位下降时间		t_{of}	-	35	45	ns
\overline{OE} 脉波宽度		$t_w(OE)$	100	130	-	ns

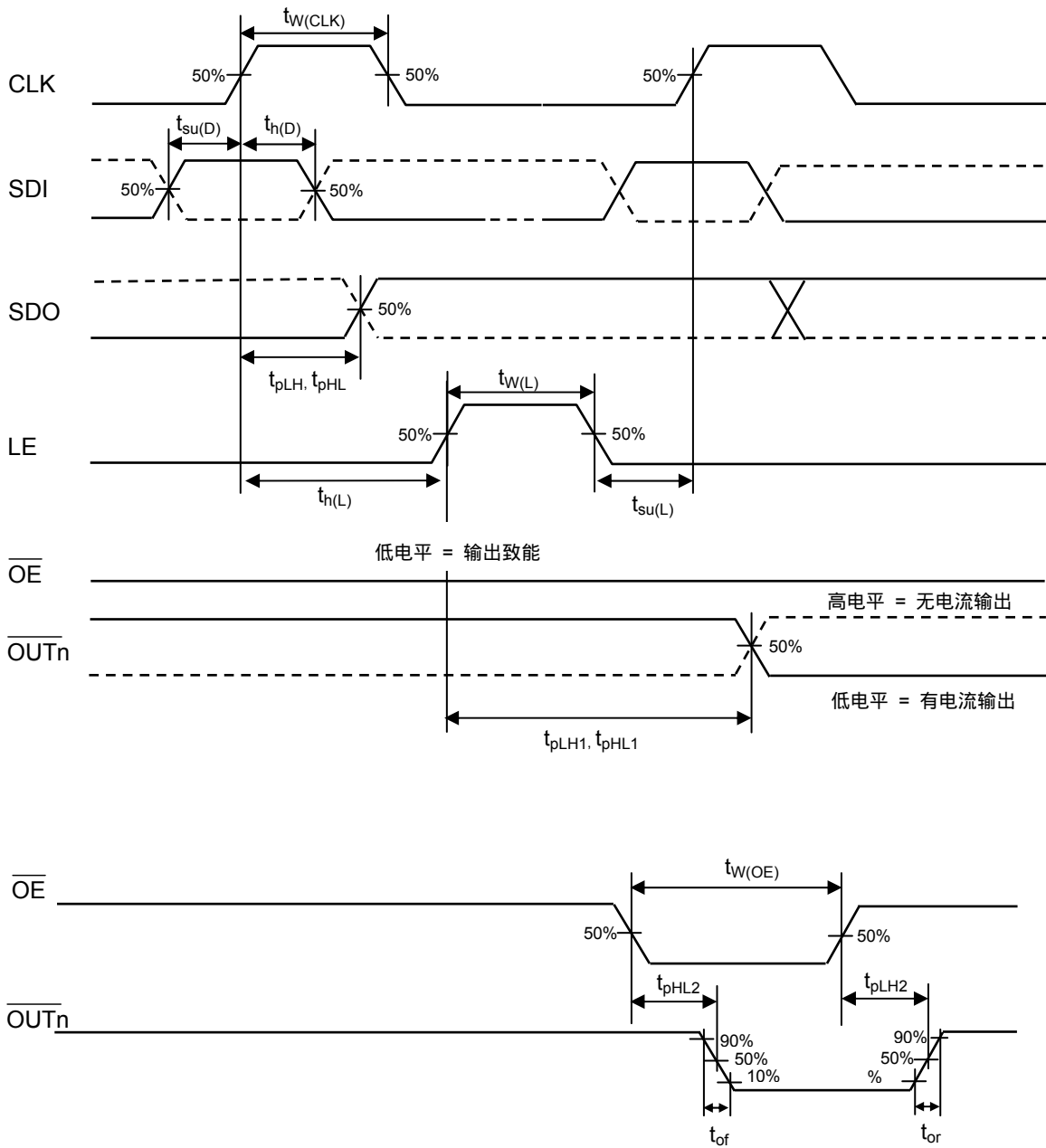
$V_{IH} = V_{DD}$
 $V_{IL} = GND$
 $R_{ext} = 930\Omega$
 $R_L = 150\Omega$
 $C_L = 10PF$
 $I_{OUT} = 20mA$
 $C1 = 100nF$
 $C2 = 22\mu F$
 $C_{SDO} = 10PF$
 $V_L = 3.3V$

*MBI5035 内建延迟电路功能,奇数信道 $\overline{OUT2n + 1}$ 与偶数通道 $\overline{OUT2n}$ 间的延迟时间为 10ns,可将奇数与偶数的输出通道在不同的时间导通来降低电源线的电流

动态特性的测试电路



时序图

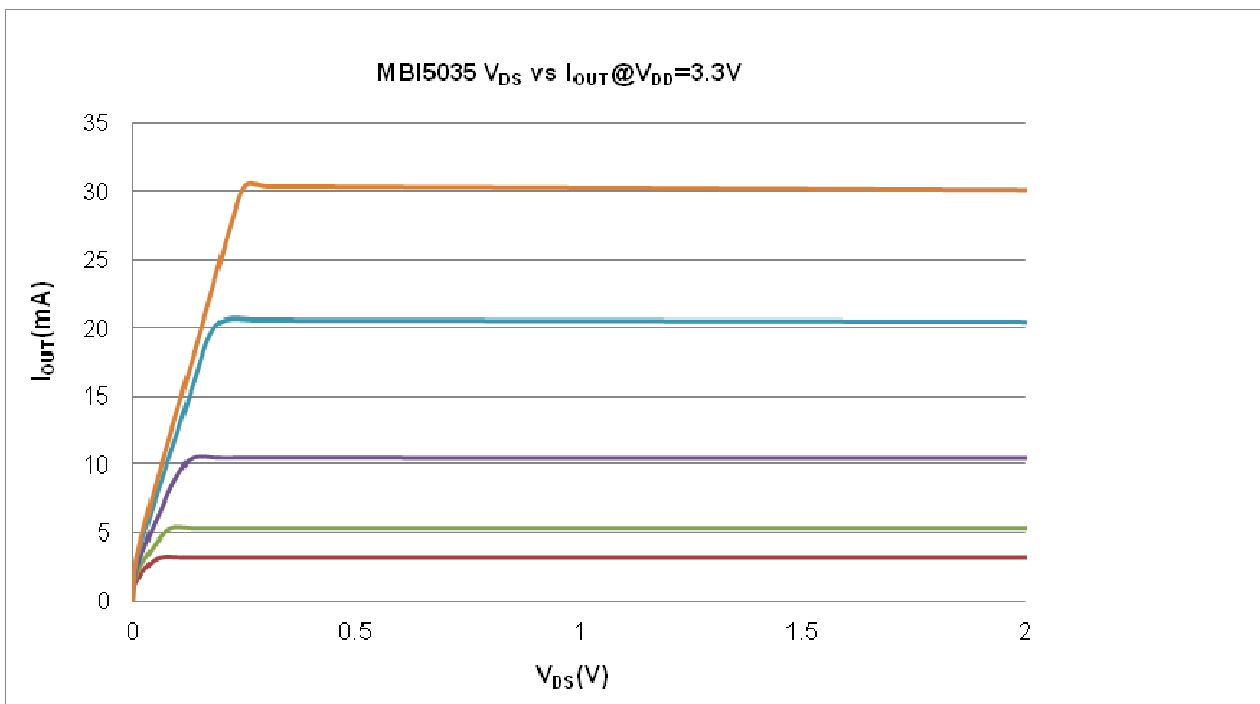
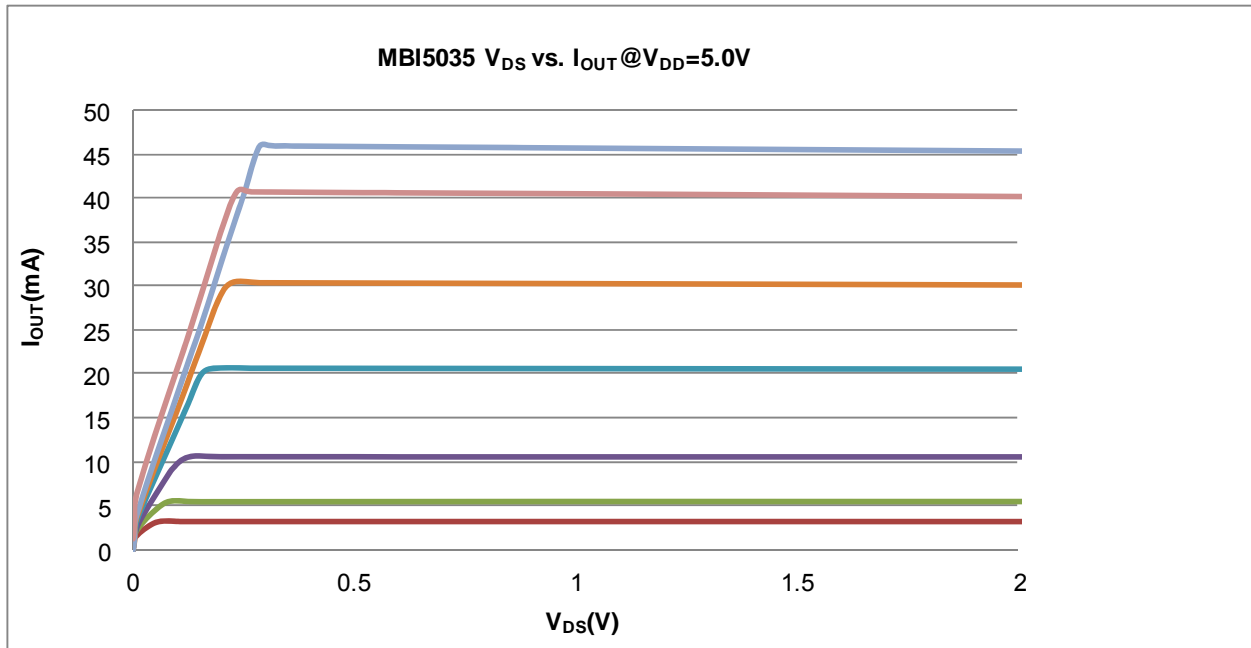


应用信息

恒流

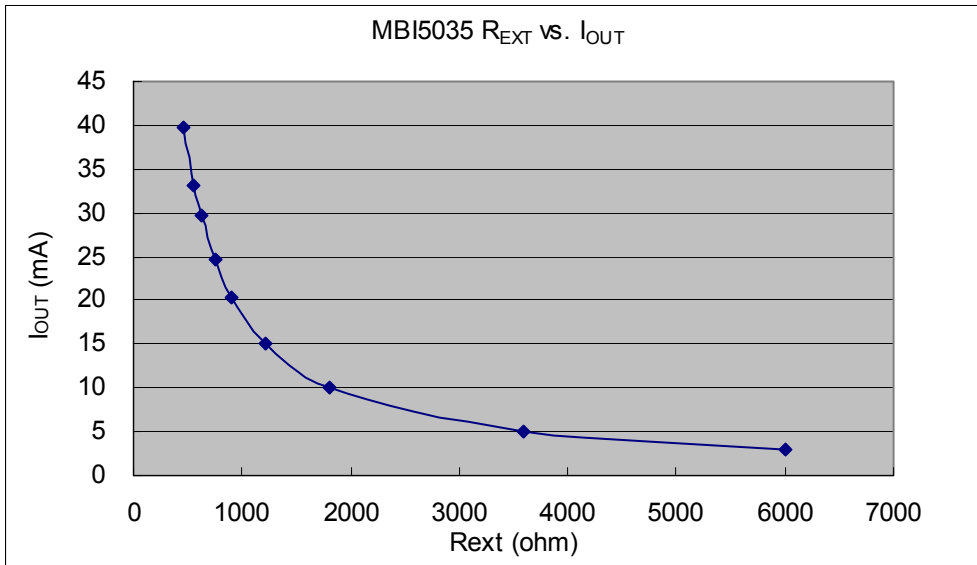
当客户将 MBI5035 应用于 LED 面板设计上时，信道间与信道间，甚至芯片与芯片间的电流，差异极小。此源自于 MBI5035 的优异特性：

- 1) 通道间的最大电流差异小于±3%，而芯片间的最大电流差异小于±6%。
- 2) 具有不受负载端电压影响的电流输出特性，如下图所示。输出电流的稳定性将不受 LED 顺向电压(V_F)变化而影响



调整输出电流

如下图所示，藉由外接一个电阻 R_{ext} 调整输出电流(I_{OUT})。



套用下列公式可计算出输出电流值，

$$V_{R-EXT}=1.24V ; I_{OUT}=V_{R-EXT} \cdot (1/R_{ext}) \times 15 ; R_{ext}=(V_{R-EXT}/I_{OUT}) \times 15$$

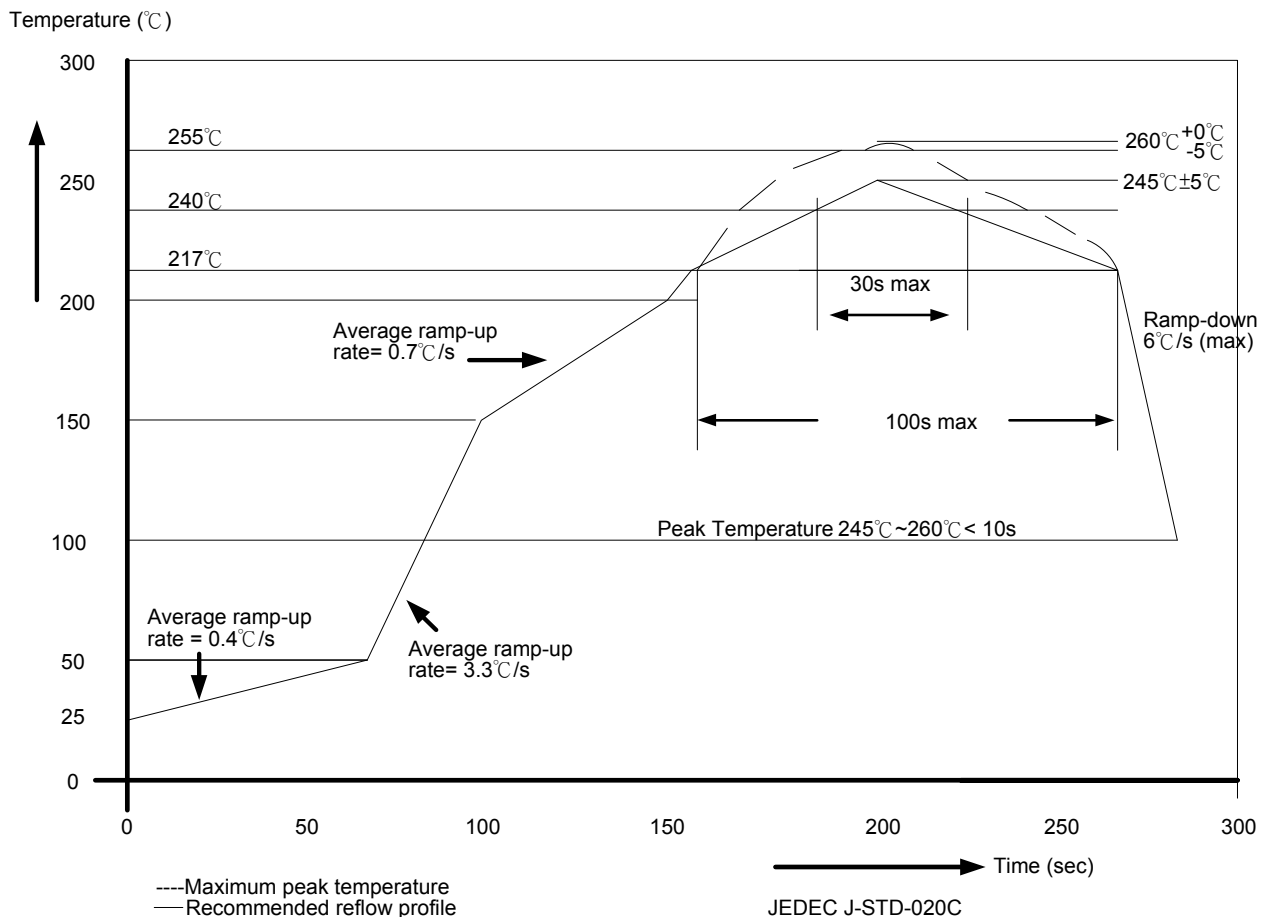
公式中的 V_{R-EXT} 是指 R-EXT 端的电压值， R_{ext} 是指外接至 R-EXT 端的电阻值。当电阻值是 930Ω，透过公式计算可得输出电流值 20mA；当电阻值是 1860Ω 时，输出的电流则为 10mA。

输出端的交错延迟时间

MBI5035 内建延迟电路机制。这 16 组电流输出端被区分成二个群组- \overline{OUT}_{2n} 与 \overline{OUT}_{2n+1} ，每个群组依照 5ns ($V_{DD}=5.0V$) 的延迟时间依序输出电流。

“Pb-Free & Green”封装之焊接制程*

聚积科技所生产的“Pb-Free & Green”的半导体产品遵循欧洲 RoHS 标准，封装选用 100%之纯锡以兼容于目前锡铅 (SnPb)焊接制程，且支持需较高温之无铅制程。纯锡目前已被欧美及亚洲区的电子产品客户与供货商广泛采用，成为取代含锡铅材料的最佳替代品。100%纯锡可生产于含锡铅(SnPb)锡炉制程，锡炉温度请参考 JEDEC J-STD-020C 标准规定。但若客户使用完全无铅锡膏和材料，则锡炉温度须达 J-STD-020C 标准之 245 °C 至 260 °C (参阅下图)。



Package Thickness	Volume mm ³ <350	Volume mm ³ 350-2000	Volume mm ³ ≥ 2000
<1.6mm	260 +0 °C	260 +0 °C	260 +0 °C
1.6mm – 2.5mm	260 +0 °C	250 +0 °C	245 +0 °C
≥ 2.5mm	250 +0 °C	245 +0 °C	245 +0 °C

*详情请参阅聚积科技之“Policy on Pb-free & Green Package”

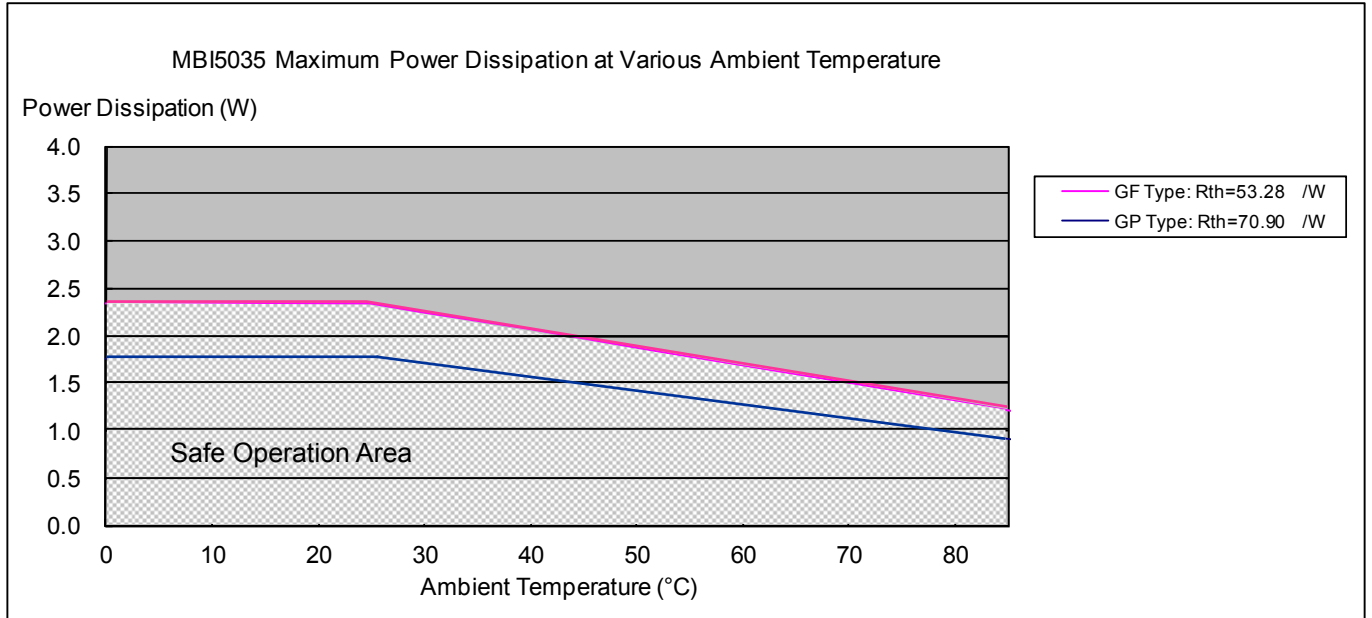
封装体散热功率 (PD)

封装体的最大散热功率，是由公式 $P_D(max)=(T_j-T_a)/R_{th(j-a)}$ 来决定。当 16 个通道同时打开时，真正的功率为 $P_D(act)=(I_{DD} \times V_{DD})+(I_{OUT} \times Duty \times V_{DS} \times 16)$ 。

为保持 $P_D(act) \leq P_D(max)$ ，可输出的最大电流与 duty cycle 间的关系为：

$$I_{OUT} = \{[(T_j - T_a) / R_{th(j-a)}] - (I_{DD} \times V_{DD})\} / V_{DS} / Duty / 16$$

其中 $T_j = 150^\circ\text{C}$



Condition: $I_{OUT}=50\text{mA}$, 16 output channels	
Device Type	$R_{th(j-a)}$ ($^\circ\text{C}/\text{W}$)
GF	53.28
GP	70.90

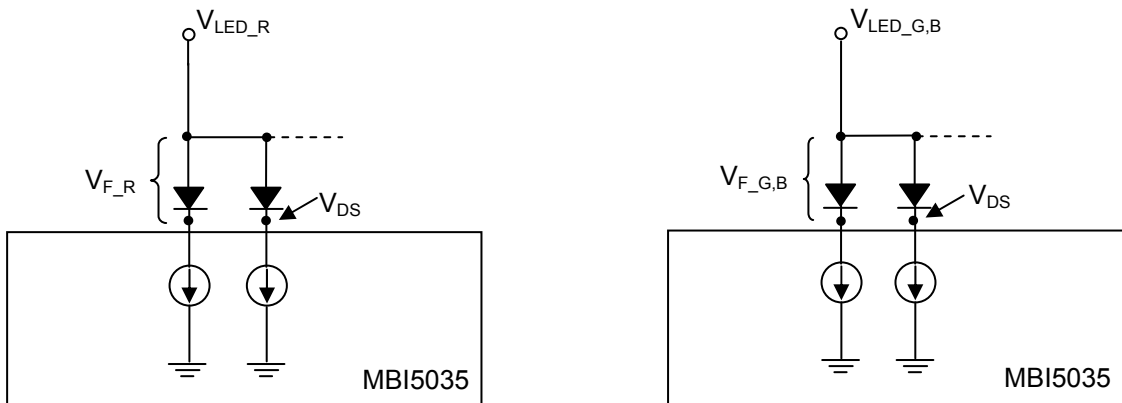
封装体的最大散热功率 $P_D(max)=(T_j-T_a)/R_{th(j-a)}$ ，随着环境温度增加而下降。

负载端供应电压 (V_{LED})

为使封装体散热能力达到优化，建议输出端电压 (V_{DS}) 的最佳操作范围是 $0.2V \sim 0.6V (I_{OUT}=3 \sim 45mA)$ 。在此状况，建议尽可能使用较低的 V_{LED} 电压供应，因为红色 LED 的 V_F 与蓝色及绿色的 LED 不同，因此建议将 V_{LED_R} 与 $V_{LED_G,B}$ 分开。

$V_{DS} = V_{LED} - V_F$ ，其中 V_{DS} 范围从 $0.2V$ 至 $0.6V$

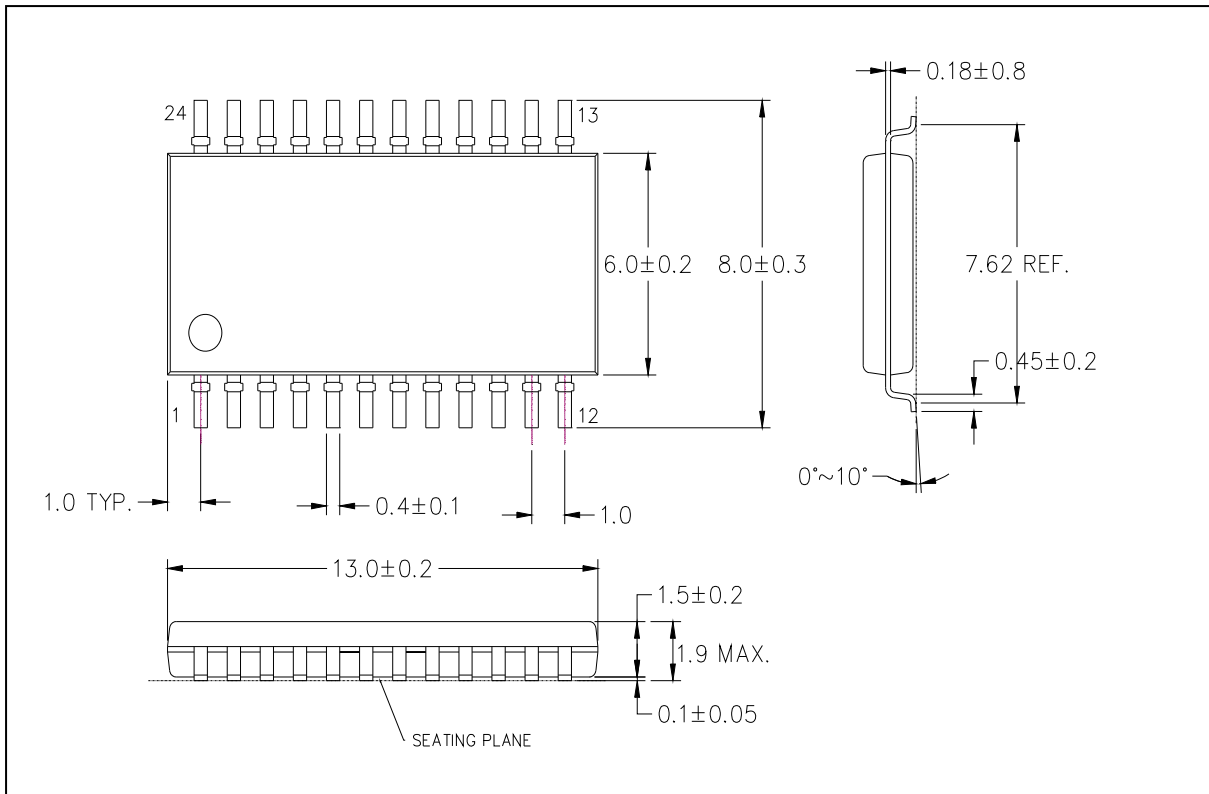
相关应用图如下：



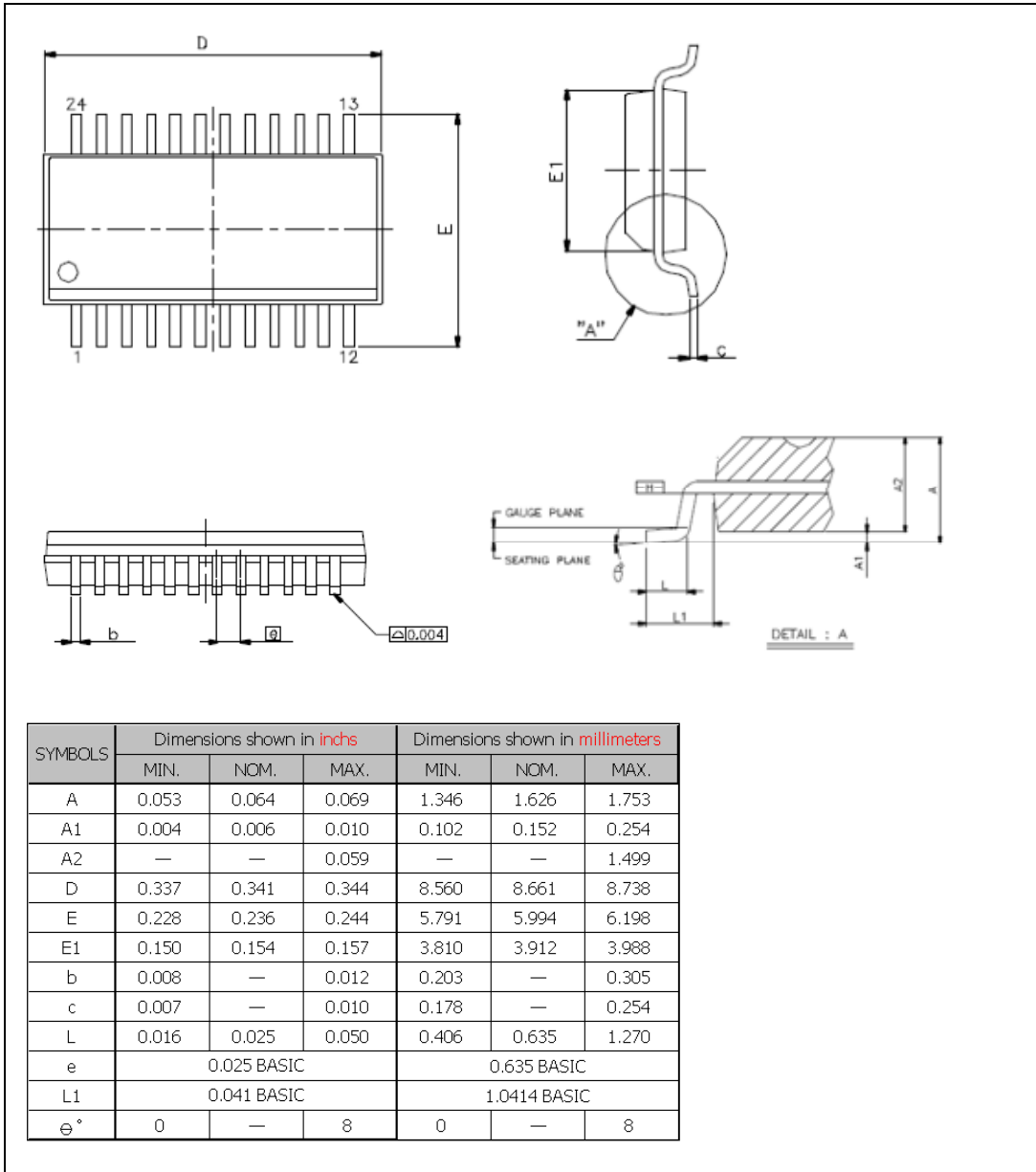
减低动态噪声

LED 驱动器常被使用在动态模式的运用，并且动态噪声的是来自于印刷电路板上的寄生电感。消除动态噪声的方法请参考应用说明书“Application Note for 8-bit and 16-bit LED Drivers- Overshoot”。

外观轮廓图示



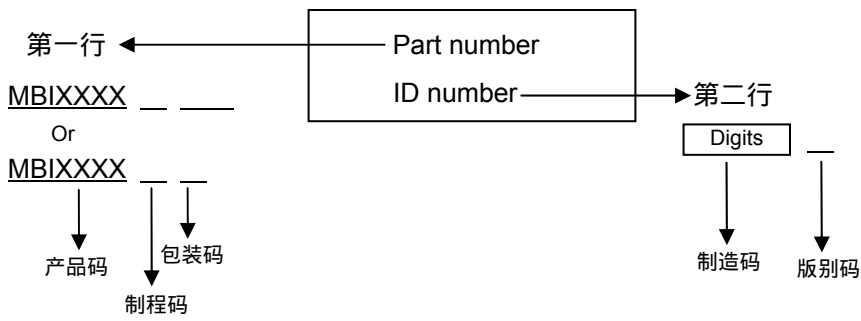
MBI5035 GF 轮廓图示



MBI5035 GP 轮廓图示

注：轮廓图标的单位是 mm。

IC 正印信息



产品更新记录

文件版次	IC 版别码
V1.00	A
V1.01	A
V2.00	B
V2.01	B

产品订购信息

产品编号	无铅环保包装	重量 (g)
MBI5035GF-B	SOP24L-300-1.00	0.28
MBI5035GP-B	SSOP24L-150-0.64	0.11

*请在您的订购单(PO)上，务必标示您的“产品订购编号”信息。

使用权声明

聚积科技对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善、以及终止的权利，针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与聚积科技业务代表联络以取得最新的产品信息。

聚积科技的产品，除非经过聚积合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，聚积科技将不负任何损害赔偿赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为聚积科技所属之智慧财产。除非是先经过聚积合法授权，任何人不得径自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表。如有违反，您应对聚积科技股份有限公司负责损害赔偿赔偿责任及其它法律责任。